

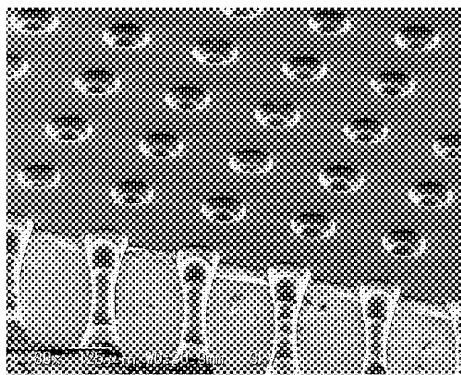
NSC、半導体向け拡大

微細穴加工、非液晶8割に

NSC（大阪府豊中市、西山翔一郎社長）は、2025年2月期までに液晶ガラス基板加工以外の売上高比率を20%から80%に高める。強みの化学表面処理技術を生かし、半導体のガラス基板に微細穴を開け銅メッキする事業を伸ばす。化学処理による黒鉛（グラフアイト）や有価資源回収、廃液処理などの部門も育て、事業転換を推し進める。全体の売り上げは伸ばしつつ、主力の液晶ガラス基板加工事業の比率は市場成熟を受け引き下げる。

NSCはスマートフォンの化学研磨で急成長している。

オンなどの液晶ガラス基板を超薄型加工する。高は約100億円。ただ液晶は海外への生産流出や有機エレクトロ



ルミネッセンス（E L）への転換で、国内市場が成熟ガラス基板に開けた微細穴

そこで高度な独自技術を持つ創業以来の化学表面処理を広げ、液晶ガラス基板加工とそれ以外の売上高比率を3年以内に逆転させる。

ガラス基板の穴開け銅メッキ技術は高集積化に優れる3次元（3D）積層半導体向け。加工が難しかったガラスに数十ミクロン（マイクロ）は100万分の1の無数の穴開けを可能

とした。ガラスは平坦性や耐熱・耐薬品性が、3D積層半導体用に適する。22年度にも3D積層半導体の量産向けに加工を始める。

ほかに高純度なグラフアイト加工やグラフアイト炭素原子層などからなる酸化グラフェンの事業も開始した。電池材料などに高い成長を見込む。スマホや

自動車のガラスから化学処理で銀や有価樹脂などを回収する技術相談も受けている。

自社工場の廃液処理で培った技術で半導体工場の廃液を処理する事業も、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成ニーズから受注を増やしている。

西山社長は「これからSDGsに欠かせない資源回収や廃物処理の事業を伸ばせる。夢は年間売上高1000億円」と意欲を示す。